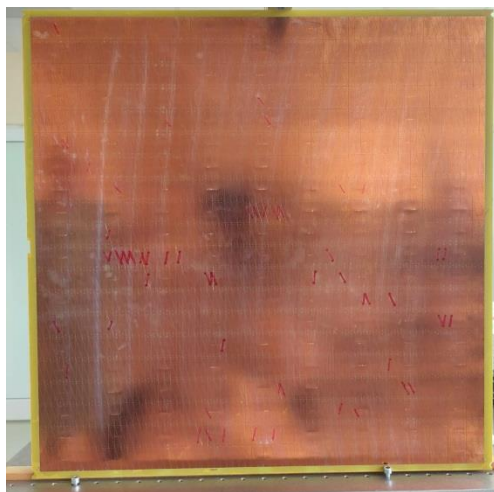


Etape montaj si teste pad-plan-uri

1. Se comanda initiala 4 buc pad-plane-uri si 4 seturi flat-uri (A, B, C, D);
2. Se trimite la lipit electric flat-uri pe un pad-plane (A) prin tehnologia nr. 1 (o poate descrie Bugi);
3. A fost testat electric inainte si dupa lipirea honeycomb-ului (informatie George) si a avut f. putine scurturi sau deloc. Se mentioneaza ca a fost folosita o tehnologie greoaie de ridicare a flat-urilor si trecerea lor prin gaurile de la honeycomb. Acesta a fost montat la prototipul care nu a trecut testele;
4. Un alt pad-plane (B) se foloseste ca mostra pentru diverse incercari (compromis);
5. Cele doua pad-plane-uri ramase (C si D) si doua seturi de flat-uri se dau la lipit electric folosindu-se doua tehnologii diferite: 1, cea folosita de la A si 2, mai speciala si mai scumpa (informatia de la Bugi);
6. Pad-plane-ul (C) este lipit electric prin tehnologia 1;
7. Se masoara electric si se confirma ca este bun (George si Vali);
8. Sufera operatia de ridicare a flat-urilor (lipire mecanica) diferita de cea folosita la pad-plan-ul (A) mentionat la pct. 3;
9. Nu se mai masoara electric;
10. Se lipeste pe honeycomb, se masoara electric, se gasesc scurturi (fig. 1);
11. Pad-plan-ul (D) lipit electric prin tehnologia 2 se masoara electric si se confirma ca este bun (Vali si George);
12. I se ridica flat-urile, folosindu-se aceasi tehnologie ca la pad-plan-ul C;
13. Se verifica electric si se constata probleme. Se remedieaza (Vali), se verifica din nou si se confirma ca e bun;
14. Este manipulat cu neatenție;
15. Nu se cunoaste informatia daca a mai fost sau nu verificat electric inainte de lipirea honeycomb-ului;
16. Se lipeste honey-comb-ul;
17. Se verifica electric si se constata din nou probleme (fig.2).



**Fig. 1 Pad-plan C
dupa montaj**



**Fig. 2 Pad-plan D
dupa montaj**

De investigat:

1. Exista posibilitatea ca lipira mecanica a flat-urilor sa conduca la alterarea conexiunilor electrice? Care a fost diferenta intre pad-plan-urile A si C, D din acest punct de vedere?
2. Trebuie confirmat sau infirmat faptul ca a fost verificat D imediat inainte de lipirea pe honeycomb;

De modificat:

1. Desen pad-plan pentru noua pozitie a gaurilor tehnologice;